

3656/A und Zu 3656/A XXVII. GP

Eingebracht am 19.10.2023

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

Antrag

**der Abgeordneten Gabriel Obernosterer, Mag. Dr. Jakob Schwarz
Kolleginnen und Kollegen,**

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft genehmigt und mit dem das Bundesgesetz hinsichtlich Begleitmaßnahmen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz) erlassen wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch den Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft genehmigt wird

§ 1. Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen beim Detailbudget 40.02.01 der Untergliederung 40 („Wirtschaft“) Vorbelastungen hinsichtlich der Finanzjahre 2024 bis 2031 für die Zwecke der nationalen Umsetzung von Vorhaben gemäß den Bestimmungen unter Kapitel III der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz) in der Höhe von bis zu 2,8 Milliarden Euro zu begründen.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen betraut.

§ 3. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Artikel 2

Bundesgesetz hinsichtlich Begleitmaßnahmen zur Durchführung von Vorhaben gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz-Begleitmaßnahmengesetz)

Gegenstand der Förderung

§ 1. Gegenstand dieses Bundesgesetzes ist die Festlegung von nationalen Zuständigkeiten hinsichtlich der Abwicklung der künftigen Förderprogramme zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems unter den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz), Abl. Nr. L 229 vom 18.9.2023 S. 1.

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

Abwicklung nach Kapitel II der Verordnung (EU) 2023/1781

§ 2. Mit der Abwicklung der Förderprogramme betreffend Kapitel II der Verordnung (EU) 2023/1781 kann die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Forschungsförderungseinrichtungen beauftragen.

Abwicklung nach Kapitel III der Verordnung (EU) 2023/1781

§ 3. (1) Mit der Abwicklung des Förderprogramms betreffend Vorhaben gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 2023/1781 wird die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Namen und auf Rechnung des Bundes beauftragt.

(2) Die liquiden Mittel werden der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf Anforderung bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt. Hierfür werden maximal 2,8 Milliarden Euro bis 2031 zur Verfügung gestellt.

(3) Die Förderung muss im Rahmen einer Prüfung durch die Europäische Kommission unmittelbar nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV genehmigt werden.

Förderungsrichtlinien

§ 4. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie eine Richtlinie für die Abwicklung des Förderprogrammes betreffend Kapitel III der Verordnung (EU) 2023/1781 zu erlassen.

(2) Die Förderungsrichtlinie gemäß Abs. 1 wird auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft veröffentlicht.

(3) Die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Richtlinien für die Abwicklung des Förderprogrammes betreffend Kapitel II der Verordnung (EU) 2023/1781 zu erlassen.

(4) Die Förderungsrichtlinien gemäß Abs. 3 werden auf der Homepage des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie veröffentlicht.

Datenübermittlung zur Abwicklung und Kontrolle

§ 5. (1) Dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung und den Forschungs- bzw. den Forschungsförderungseinrichtungen sind zum Zwecke der Abwicklung und Kontrolle von Förderungen nach diesem Bundesgesetz von den Abgabenbehörden die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie auf ihre Anfrage unter Verwendung einer elektronischen Schnittstelle soweit verfügbar Daten zu übermitteln, die für die Kontrolle notwendig sind.

(3) Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie werden ermächtigt, die nähere Ausgestaltung der Überprüfung des Vorliegens der Fördervoraussetzungen sowie weitere zur Kontrolle erforderliche datenschutzrechtliche Bestimmungen (insbesondere allfällige Anpassungen oder Ergänzungen von Daten) durch Aufnahme in die Förderungsrichtlinie gemäß § 4 festzulegen.

Vollziehung

§ 6. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut:

1. hinsichtlich des § 2 und des § 4 Abs. 4 die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie,
2. hinsichtlich des § 4 Abs. 1 der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie,
3. hinsichtlich des § 4 Abs. 3 ist die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft,
4. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 der Bundesminister für Finanzen, die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft,
5. hinsichtlich des § 5 Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen,
6. hinsichtlich des § 5 Abs. 3 der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft und die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und
7. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

Schlussbestimmungen

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31.12.2032 außer Kraft.

(2) Sämtliche in diesem Bundesgesetz verwendeten Funktionsbezeichnungen und personenbezogenen Ausdrücke sind geschlechtsneutral zu verstehen.

(3) Mit diesem Bundesgesetz werden die Zuständigkeiten für das Förderprogramm für Vorhaben unter den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 festgelegt.

Begründung:

Zu Artikel 1

Halbleiter (oder Chips) sind nicht nur die treibende Kraft des digitalen Wandels, ihre Verfügbarkeit und technische Funktionalität ist auch wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Vor dem Hintergrund der weltweiten Verknappung von Chips, den sich verschärfenden geopolitischen Konflikten und dem zunehmenden nationalen Protektionismus in den wichtigsten Produktionsregionen der Welt wurde das Europäische Chip-Gesetz (*Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694*) vom EU Parlament sowie dem Rat der EU im Juli 2023 beschlossen und ist am 21. September in Kraft getreten. Dabei soll der EU-Anteil an der globalen Chips-Produktion von aktuell unter 10 Prozent bis 2030 auf 20 Prozent verdoppelt werden. Der Rechtsakt umfasst mehrere Interventionsebenen und basiert auf einer Drei-Säulen-Struktur:

- Säule 1 im Kapitel II der VO: Chips for Europe Initiative – dient der Förderung des Aufbaus großer angelegter technologischer Kapazitäten und Innovationen im Ökosystem der EU-Halbleiterhersteller und soll unter dem Titel „Chips für Europa“ den Übergang vom Labor zur Fertigung verbessern. Die Säule 1 wird im Rahmen eines Gemeinsamen Unternehmens, des Joint Undertakings Chips (JU-Chips) umgesetzt werden.
- Säule 2 im Kapitel III der VO: schafft einen Rahmen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit mit Chips in der EU, indem in- und ausländische Investitionen angezogen und der Aufbau neuer Produktionskapazitäten unterstützt werden. Der Rahmen ermöglicht die Gewährung von Beihilfen auf Basis einer Prüfung durch die Europäische Kommission unmittelbar nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV. Die Säule 2 wird bei Bedarf aus nationalen Mitteln umgesetzt und bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur Deckung der Finanzierungslücke neuartiger Produktionsanlagen der Unternehmen.
- Säule 3 im Kapitel IV der VO: dient dem Aufbau eines Mechanismus für die Überwachung und Krisenreaktion entlang der gesamten Lieferkette. In engem Austausch mit den relevanten Unternehmen wird für die Krisenerkennung auf Basis von Frühwarnindikatoren die Resilienz der Wertschöpfungskette überwacht und im Falle einer Krise für die Krisenbekämpfung ein Werkzeugkasten zur Krisenreaktion etabliert.

Das gegenständliche Gesetz dient der Umsetzung von Projekten unter den Bestimmungen des Kapitel II des Chips-Gesetz (Chips für Europa Initiative) sowie Unternehmensinvestitionen unter den Bestimmungen des Kapitel III des europäischen Chip-Gesetzes. Die Steigerung der Resilienz in Bezug auf strategische Schlüsseltechnologien ist für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des heimischen Arbeitsmarktes wesentlich. Unterstützt wird unter den Bestimmungen des europäischen Chip-Gesetzes der Aufbau von neuartigen Anlagen im Halbleitersektor, die gem. Art. 13 der Verordnung (EU) 2023/1781 als Integrierte Produktionsstätte bzw. gem. Art. 14 der Verordnung (EU) 2023/1781 als offener EU-Fertigungsbetrieb gelten:

i. Integrierte Produktionsstätten sind neuartige Anlagen für die Fertigung und gegebenenfalls auch den Entwurf von Halbleitern, oder für die Herstellung von Ausrüstung oder Schlüsselkomponenten für diese Ausrüstung, die überwiegend in der Halbleiterfertigung in der Union verwendet werden, was auch andere Stufen der Lieferkette einbeziehen kann, welche zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems der Union beitragen; gegebenenfalls können sie zusätzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferketten beitragen.

ii. Offene EU-Fertigungsbetriebe sind neuartige Anlagen oder Halbleiterfertigungsanlagen in der Union, die von ihnen unabhängigen Unternehmen Produktionskapazität anbieten und somit zur Versorgungssicherheit für den Binnenmarkt und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems der Union beitragen; und gegebenenfalls können sie zusätzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferkette beitragen.

iii. Förderungswerber müssen bei der Europäischen Kommission den Status als Integrierte Produktionsstätte bzw. Offener EU-Fertigungsbetrieb beantragen.

iv. Die Beihilfe muss von der Europäischen Kommission im Rahmen einer Prüfung durch die Europäische Kommission unmittelbar nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV genehmigt werden.

Für die Umsetzung der Maßnahmen zum Aufbau von Produktionskapazitäten in Österreich bedarf es entsprechender budgetäre Mittel.

Eine Vorbelastung darf gemäß § 60 Abs. 4 Ziffer 1 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), BGBl. I Nr. 139/2009 idgF, nur aufgrund einer bundesgesetzlichen Ermächtigung erfolgen, wenn deren zugehörige Auszahlungen jeweils jährlich in zumindest einem folgenden Finanzjahr den Anteil von 10 vH der bei der jeweiligen Untergliederung im zuletzt kundgemachten Bundesfinanzrahmengesetz vorgesehenen Auszahlungsobergrenze übersteigen würden. Im Hinblick auf die in der geltenden Fassung BGBl. I Nr. 184/2022 für die Untergliederung 40 (Wirtschaft) vorgesehene Auszahlungsobergrenzen für die Jahre 2024 in der Höhe von 1.129,485 Mio. Euro, 2025 in der Höhe von 870,875 Mio. Euro, 2026 in Höhe von 500,890 Mio. Euro liegt die Betragsgrenze nach § 60 Abs. 4 Ziffer 1 BHG im Jahr 2024 bei rd. 113 Mio. Euro, im Jahr 2025 bei rd. 87 Mio. Euro und im Jahr 2026 bei rd. 50 Mio. Euro. Für die Begründung der erforderlichen gegenständlichen Vorbelastungen für die Finanzjahre 2024 bis 2031 ist daher eine bundesgesetzliche Ermächtigung einzuholen.

Das vorliegende Gesetz soll daher die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Begründung jener Vorbelastungen schaffen, die durch die nationale Umsetzung Projekte unter Kapitel III des Europäischen Chips Gesetz bis 2031 entstehen. Das vorliegende Gesetz soll demzufolge dazu ermächtigen, Vorbelastungen in Höhe von bis zu 2.800.000.000 Euro in den Finanzjahren 2024 bis 2031 zu begründen. Für den Zeitraum des BFRG 2024 bis 2027 sowie 2028 bis 2031 ergeben sich folgende Beträge:

2024: 150.000.000 Euro

2025: 100.000.000 Euro

2026: 75.000.000 Euro

2027: 75.000.000 Euro

2028 - 2031: bis zu 2.400.000.000 Euro

Die ausgewiesenen Beträge stellen ausschließlich die zukünftigen Belastungen beginnend mit dem Finanzjahr 2024 dar. Der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft wird daher im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen ermächtigt, die erforderlichen Vorbelastungen in Höhe von bis zu 2.800.000.000 Euro hinsichtlich des Zeitraums 2024 bis 2031 zu begründen.

Zu Artikel 2

Die Gewährung von Förderungen unter den Bestimmungen des Kapitel III des europäischen Chip-Gesetzes erfolgt auf Basis von Richtlinien, die der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen sowie der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erlässt. Abwicklungsstelle soll die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. Reziprok ist vorgesehen, dass Richtlinien hinsichtlich Förderungen nach Kapitel II des europäischen Chip-Gesetzes, welche von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie erlassen werden, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen sowie dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft erfolgen.

In formeller Hinsicht wird ersucht, diesen Antrag nach Durchführung der ersten Lesung dem Budgetausschuss zuzuweisen.